



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

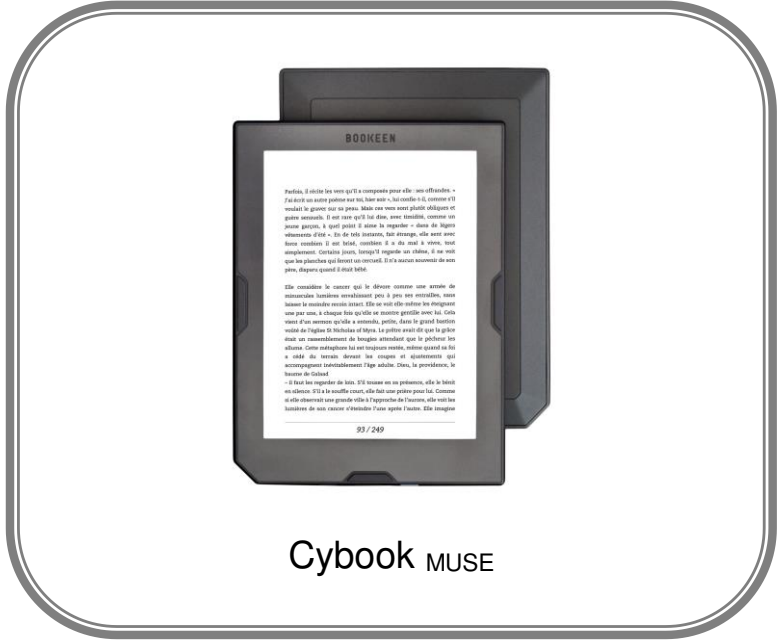
DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
	NOM :	
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
NE RIEN ECRIRE	Prénoms :	N° du candidat
	Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
	<i>Appréciation du correcteur :</i>	
Note : / 20		

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

# Baccalauréat Professionnel Microtechniques Session 2020

## E2 – ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE Préparation d'une intervention microtechnique

### DOSSIER SUJET (DS)



Le dossier sujet (DS) est à rendre dans sa totalité  
« L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé. ».

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 1 / 8

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

**A - PRÉSENTATION DE L'ÉPREUVE**

**A1 - Mise en situation**

Le Cybook<sub>muse</sub> est une liseuse. C'est un appareil mobile conçu principalement pour afficher des livres numériques (ebook). L'appareil est doté d'un écran pour l'affichage et doit permettre le stockage des publications numériques permettant ainsi de créer une bibliothèque numérique portable DTR 2/7.



**A2 - Problématique**

Un lot de 30 liseuses Cybook<sub>muse</sub> est retourné au SAV (*Service Après-Vente*) de la société Bookeen suite à une « **défaillance de mise en marche** », commune aux 30 liseuses.

L'équipe du SAV doit identifier l'origine du problème afin de mettre en place une procédure de réparation pour un retour client dans les plus brefs délais.

**A3 - Matériel autorisé**

- Calculatrice.

**A4 - Documents fournis**

- Dossier Sujet (noté DS 1/8 à DS 8/8).
- Dossier Technique et Ressource (noté DTR 1/7 à DTR 7/7).

**A5 - Documents autorisés**

- Aucun document autorisé.

**A6 - Documents à rendre**

- Dossier sujet.

**A7 - Barème de correction**

		(*) : Durée conseillée	Durée (*)	Page	Barème de correction
Lecture du sujet			15 min		
A – Présentation de l'épreuve				2/8	
Atelier de maintenance SAV Bookeen	B – Analyse fonctionnelle		20 min	3/8	/ 7
	C – Recherche du dysfonctionnement		20 min	4/8 - 5/8	/ 6
	D – Fabrication de la plaque support		45 min	6/8 - 7/8	/ 16
	E – Intervention de réparation		20 min	7/8 - 8/8	/ 11
			120 min	Sous Total	/ 40
				TOTAL	/ 20

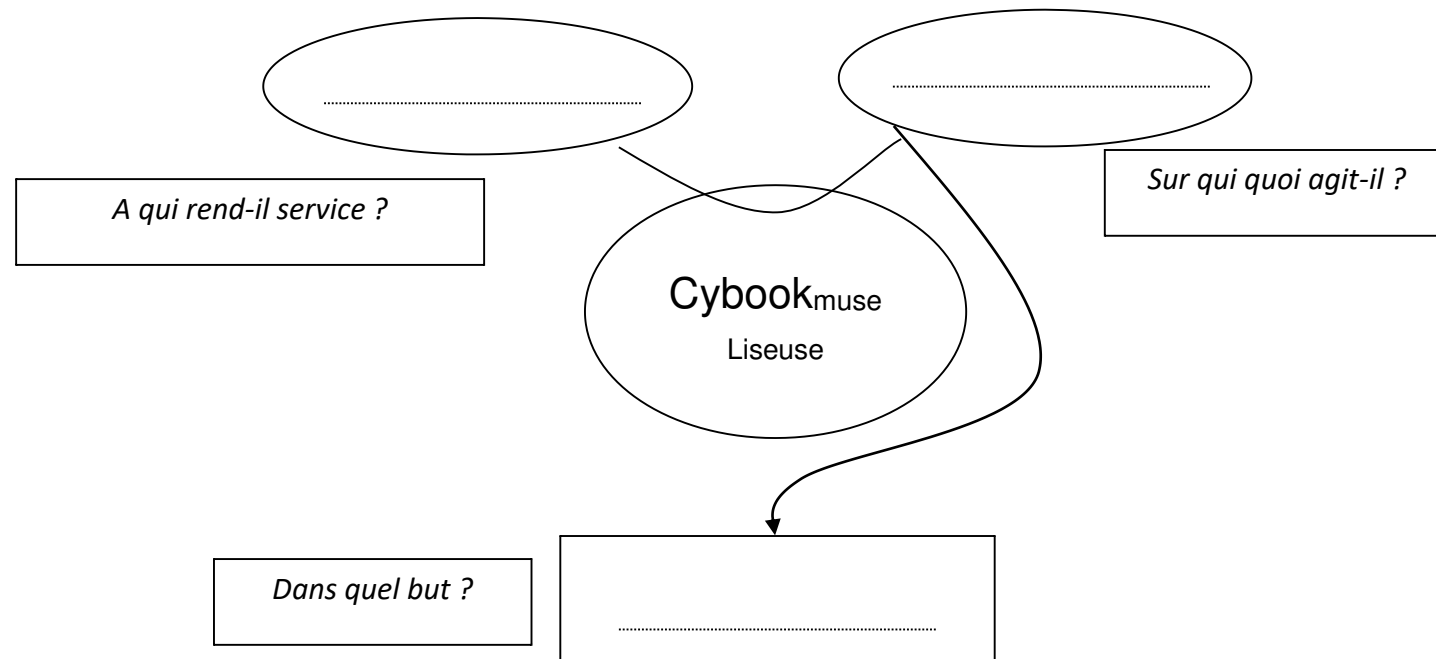
Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 2 / 8

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

**B - ANALYSE FONCTIONNELLE**

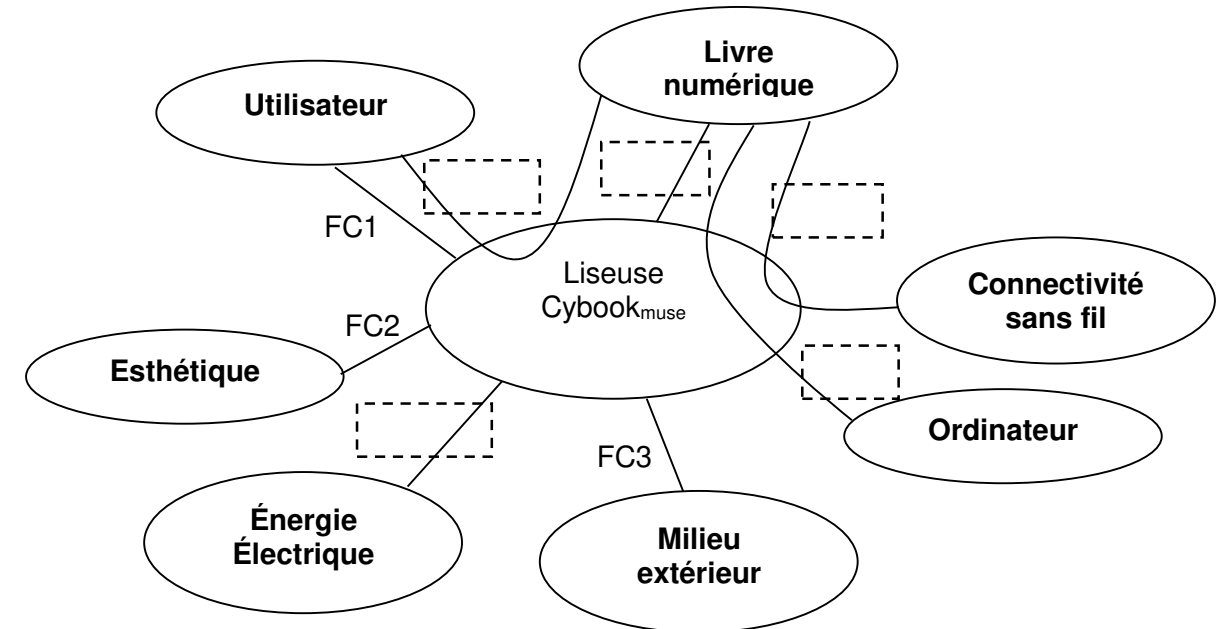
**B1 – Énoncé du besoin :**

B1.1 À l'aide de la mise en situation DS 2/8, compléter l'énoncé du besoin de la liseuses Cybook<sub>muse</sub> ci-dessous :



**B2 – Diagramme des interacteurs :**

B2.1 Compléter ci-dessous, les fonctions principales et les fonctions contraintes de la liseuse Cybook<sub>muse</sub>



- FP1 : Permettre à l'utilisateur de lire un livre numérique
- FP2 : Télécharger des livres numériques à partir d'un ordinateur
- FP3 : Télécharger des livres numériques par connectivité sans fil
- FC1 : Intégrer l'ergonomie
- FC2 : Répondre aux critères d'esthétisme
- FC3 : Résister au milieu extérieur
- FC4 : Stocker les données
- FC5 : Posséder une alimentation autonome

**B3 – Fonction défailante :**

B3.1 Indiquer la fonction de contrainte liée à la problématique « défaillance de mise en marche » ?

**B4 – Éléments défailants :**

B4.1 Identifier les quatre sources de défaillances dans le cas d'un problème de "mise en marche" d'après le protocole d'intervention DTR 2/7.

.....

.....

.....

**Total B / 7 pts**

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 3 / 8

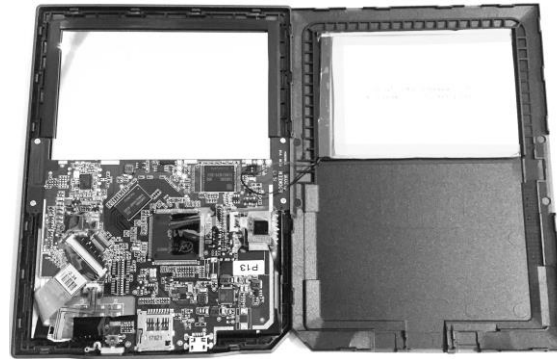
NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

## C - RECHERCHE DU DYSFONCTIONNEMENT

Pour identifier l'origine du dysfonctionnement, un protocole d'intervention est mis en place DTR 2/7.

### C0 – Contrôle des connectiques :

Après ouverture de la liseuse, le technicien constate que toutes les nappes de la carte mère sont correctement connectées DTR 3/7.



### C1 – Test de la carte mère :

Procédure de test de la carte mère :

- a – Débrancher la batterie
- b – Alimenter la carte mère
- c – Allumer la liseuse

#### Alimentation de la carte mère

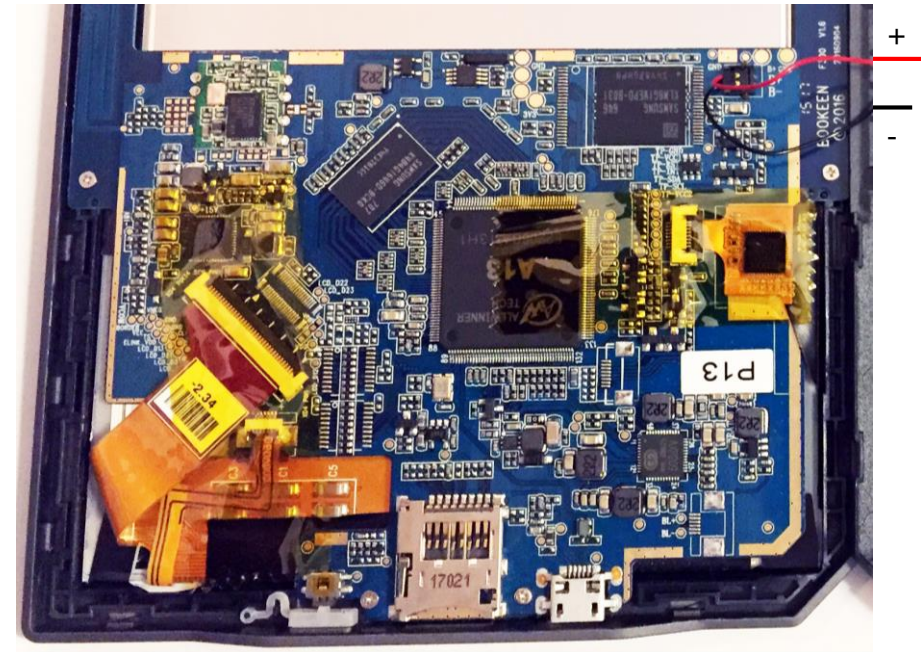
C1.1 À l'aide du DTR3/7, **indiquer** ci dessous la valeur de la tension à vide **E** délivrée par la batterie qui alimente la carte mère. (*Préciser l'unité de la valeur*).

E = .....

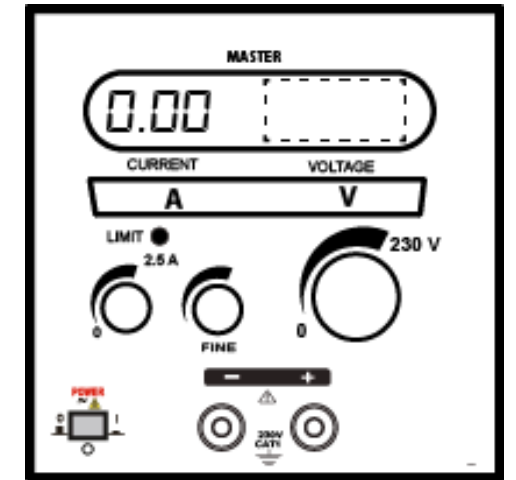
C1.2 **Reporter** la valeur de réglage sur l'alimentation stabilisée ci-contre.

#### Câblage de la carte mère

C1.3 **Tracer**, ci-dessous le câblage pour alimenter la carte mère.



Alimentation stabilisée



Conclusion du test de la carte mère :

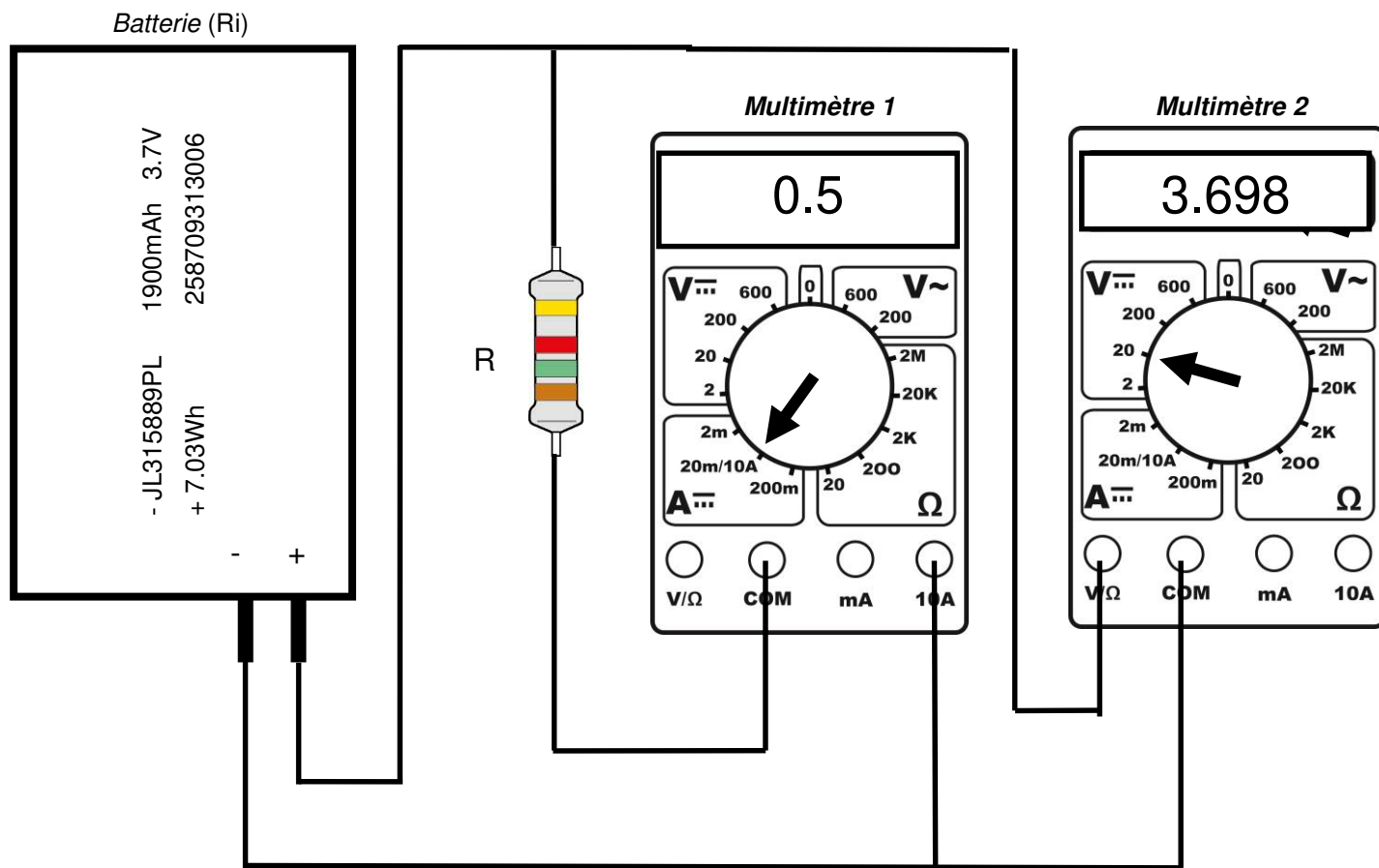
Le technicien constate que la liseuse fonctionne, la carte mère n'est pas mise en cause dans le dysfonctionnement. Le technicien doit poursuivre le protocole d'intervention et teste la batterie.

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 4 / 8

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

**C2 – Test de la batterie :**

Pour vérifier le bon état de la batterie, il est nécessaire de calculer sa résistance interne (Ri) DTR 3/7.  
Le technicien effectue le câblage ci-dessous pour mesurer les différentes valeurs nécessaires, à l'aide de deux multimètres et de la résistance (R).



Calcul de la résistance interne de la batterie

C2.1 **Calculer** la valeur de la résistance interne (Ri) de la batterie, indiquer l'unité.

Formule

Calcul

Résultat en mΩ

Ri =

Ri =

Ri =

**Total C / 6 pts**

C2.2 Bilan du test de la batterie.

Suite au résultat précédent et à l'aide du document ressource DTR 3/7, **indiquer** dans quel état se trouve la batterie, **justifier** la réponse.

.....  
 .....  
 .....

C2.3 Conclure sur les résultats du test de la batterie.

.....  
 .....

**C3 – Dernier contrôle**

C3.1 Identifier à l'aide du protocole d'intervention DTR 2/7, le dernier élément à contrôler source du dysfonctionnement de la liseuse :

.....  
 .....

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 5 / 8

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

## D - FABRICATION DE LA PLAQUE SUPPORT

Dans le lot de 30 liseuses, 27 liseuses présentent une défaillance de la prise micro USB.  
Pour optimiser le temps d'intervention du remplacement des connecteurs, le soudage et le dessoudage seront effectués à l'aide d'une plaque chauffante DTR 4/7.  
Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser un support spécifique « plaque support » (Rep3).

### D1 - Étude de la plaque support

#### Fonctions de la plaque support.

D1.1 À l'aide du DTR 4/7, **identifier** les fonctions de la plaque support.  
Cocher la/les case(s) correspondante(s).

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Protéger les autres composants | <input type="checkbox"/> Conduire la chaleur                  |
| <input type="checkbox"/> Décorer la plaque chauffante   | <input type="checkbox"/> Protéger le technicien               |
| <input type="checkbox"/> Mettre en position             | <input type="checkbox"/> Laisser passer la chaleur localement |

#### Matière de la plaque support.

D1.2 À l'aide du DTR 6/7, **déterminer** la matière pour fabriquer la « plaque support », sachant que la conductivité thermique doit être la plus faible possible. Justifier votre choix.

.....

.....

.....

### D2 - Préparation de la fabrication de la plaque support

#### Moyen de fabrication

D2.1 **Identifier** la machine permettant d'usiner la poche et les trous taraudés de la plaque support, à l'aide du DTR 5/7.

- |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Impression 3D            | Electroérosion           | Tour                     | Fraiseuse                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Usinage de la poche de la plaque support

D2.2 À l'aide du contrat de phase et du dessin de définition DTR 5/7, **identifier** l'outil nécessaire pour usiner la poche.

- |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fraise Ø 10              | Fraise Ø 6               | Foret à pointer          | Foret Ø 8                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Perçage de la plaque support

D2-3 À l'aide des DTR 5/7 et DTR 7/7, **calculer** le diamètre de perçage des trois trous taraudés M5 de la plaque support.

Formule

Calcul détaillé

Résultat, préciser l'unité.

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 6 / 8

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

Coordonnées d'usinage de la plaque support.

D2.4 À l'aide du dessin de définition et du contrat de phase DTR 5/7, **compléter** le tableau des coordonnées des points A, B, C, et D.

Point	X	Y
OP	0	0
A		
B		
C		
D		

Paramètres de coupe

D2.5 À l'aide du DTR 5/7, **compléter** le tableau ci-dessous.

Opération	Ø outil	Nombre de dents Z	Vitesse de coupe Vc (m/min)	Fréquence de rotation N (tr/min)	Avance par dent fz (mm/dt/tr)	Vitesse d'avance Vf (mm/min)
Pointage						

- N =
- Vf =

**Total D /16 pts**

**E - INTERVENTION DE RÉPARATION**

*L'usinage de la plaque support est terminé. Les trois vis M5 sont vissées. La carte mère est mise en position sur la plaque support. L'ensemble est placé sur la plaque chauffante qui est à température. Le technicien peut procéder au remplacement des connecteurs micro USB des liseuses concernées.*

**E1 – Dessoudage du connecteur micro USB.**

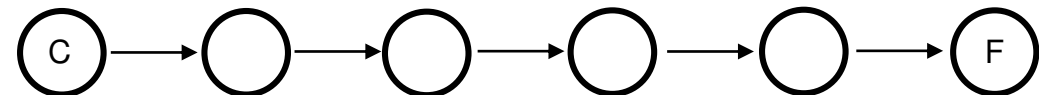
E1.1 À l'aide du DTR 6/7, **identifier** le ou les matériels nécessaires pour l'intervention sur le connecteur micro USB.

- Pince multiprise       Pince à dénuder       Pince brucelle  
 Tresse à dessouder       Flux de nettoyage       Tournevis       Ventouse

**E2 – Soudage du connecteur micro USB.**

E2.1 À l'aide du DTR 6/7, **ordonner** les étapes d'interventions pour souder le connecteur micro USB sur la carte mère.

- A Appliquer de la pâte à souder sur la carte mère
- B Attendre dix secondes que la pâte à souder devienne liquide
- C Mise en position de la carte mère sur la plaque support
- D Retirer la carte mère du support
- E Positionner le nouveau connecteur micro USB
- F Nettoyage de la carte mère avec le nettoyant de flux de soudure.










Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 7 /8

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

**E3 – Remontage de la liseuse**

E3.1 **Compléter** la gamme de montage ci-contre à l'aide des DTR 3/7 et DTR 7/7

- Équipement du poste
- Équipement du technicien
- Désignation des opérations des étapes 2 et 6
- Désignation des outillages/matériels des étapes 2 et 5

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">BOOKEEN</h1> <p style="margin: 0;">GAMME DE MONTAGE</p> </div> </div>				
		Équipement du poste de travail		.....
		Équipement du technicien		.....
Étape	Opération	Outillages / matériels	Remarques	Images
1	Placer la carte mère dans la coque avant	Aucun	Attention aux nappes de connexions et au bouton marche/arrêt	
2	..... .....	..... .....	Attention au serrage	
3	Connecter les 3 nappes : - Soulever le clip de connexion - Mettre en position la nappe - Refermer le clip	Aucun	Attention au bon positionnement des nappes, vérifier le clipsage	
4	Connecter la batterie	Aucun	Vérifier le clipsage	
5	Protéger les nappes	..... .....	Vérifier le collage	
6	..... .....	Aucun	Attention au connecteur micro USB	

**Total E /11 pts**

Baccalauréat Professionnel MICROTECHNIQUES		
Repère de l'épreuve : 2006 MIC T 1	Durée : 2 heures	Coefficient : 3
Session : 2020	Dossier Sujet	DS 8 / 8

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.